長庚大學醫療機電工程研究所
畢 業 生 僱 主 調 查 問 卷

說明

長庚大學醫療機電工程研究所為參加國際工程教育認證，以提升本所教育品質、畢業生就業之競爭力，達成提高本所學術聲譽、社會認同及工程教育國際化目標，希望您能協助填答本份問卷，非常謝謝您。

一、 工作態度

	極滿意	滿意	普通	不滿意	極不滿意	無意見
專業知識與技能	□	□	□	□	□	□
專業實習經驗	□	□	□	□	□	□
電腦學習應用能力	□	□	□	□	□	□
分析思考能力	□	□	□	□	□	□
外語能力	□	□	□	□	□	□
學習意願	□	□	□	□	□	□
積極主動性	□	□	□	□	□	□
敬業負責	□	□	□	□	□	□
注重工作倫理	□	□	□	□	□	□
人際溝通	□	□	□	□	□	□
領導能力	□	□	□	□	□	□
團隊合作	□	□	□	□	□	□
品格操守	□	□	□	□	□	□
儀容談吐	□	□	□	□	□	□
基本法律通識知識	□	□	□	□	□	□
國際視野	□	□	□	□	□	□
社會關懷	□	□	□	□	□	□
整體表現	□	□	□	□	□	□
與單位其他人相比	□	□	□	□	□	□
是否再聘 CGU 學生	□	□	□	□	□	□

二、 適任性

	極滿意	滿意	普通	不滿意	極不滿意	無意見
理論分析能力	□	□	□	□	□	□
醫療機電工程設計與分析能力	□	□	□	□	□	□
醫療機電實驗規劃與執行能力	□	□	□	□	□	□
口頭報告及溝通能力	□	□	□	□	□	□
計劃書與論文撰寫能力	□	□	□	□	□	□
應用工程相關軟硬體工具能力	□	□	□	□	□	□
醫療實務應用能力	□	□	□	□	□	□
使用外語及資料檢索吸收科技新知能力	□	□	□	□	□	□